

Schweizer offeriert HDI- und HF-Combi-Board **Flexibel LP-Technologien kombinieren**

Schweizer Electronic offeriert das HDI- (High Density Interconnect) und das HF-Combi-Board (Hochfrequenz). Beide Boards erlauben ein Höchstmass an Flexibilität in der Kombination von verschiedenen Materialien und unterschiedlichen Leiterplatten-Typen. Das bereits eingeführte Power-Combi-Board kombiniert Dickkupfer bis 400 µm und Finepitch-Leiterplattelemente in einem Board. Das HDI-Combi-Board wurde für Applikationen entwickelt, bei dem sehr komplexe Bauelemente wie Microcontroller mit Standard-Bauelementen auf möglichst kleinem Bauraum kombiniert werden. Es werden mehrlagige HDI-Strukturen mit Standard-Multilayern mit geringer Lagenzahl kombiniert. So muss etwa für komplexe Bauelemente die kostenintensive HDI-Mehrlagigkeit nur dort eingesetzt werden, wo sie wirklich benötigt wird. Ein Entflechten über die gesamte Leiterplatte kann somit entfallen. Das HF-Combi-Board kombiniert Hochfrequenz- mit Standardleiterplatten. Diese Kombination reduziert den Einsatz von teuren Materialien, wie keramisch gefüllten Basismaterialien.